

PRESSEINFORMATION

PRESSEINFORMATION

08.05.2024 || Seite 1 | 2

Rapidus und Fraunhofer IZM kooperieren im Bereich High-End Performance Packaging

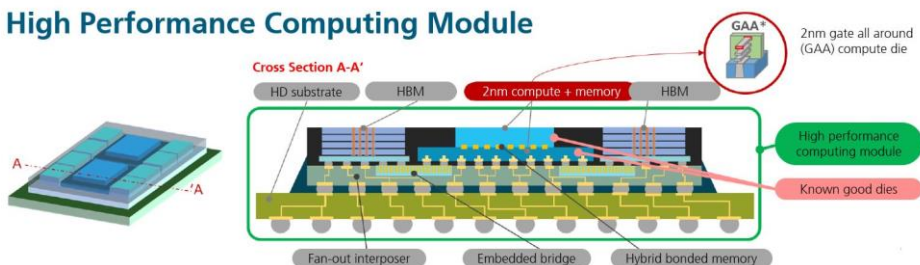
Das japanische Unternehmen Rapidus Corp., Hersteller von High-End-Mikroelektronik, und das Fraunhofer IZM, ein weltweit führendes Forschungsinstitut im Bereich der Mikroelektronik, arbeiten gemeinsam an neuen Packaging-Lösungen für Hochleistungs-Computing-Module mit 2nm Transistorknotengröße.

Rapidus baut auf der Insel Hokkaido eine Halbleiterfabrik zur Fertigung von Mikrochips in 2nm Technologie und den dazugehörigen High-End Packages. METI, Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, fördert 2024 die Forschung und Entwicklung von Integrationstechnologie für 2nm Halbleiter bei Rapidus.

Das Fraunhofer IZM freut sich sehr über die Kooperation zu einem der wichtigsten Themen der nahen Zukunft - die Realisierung von Modulen für z.B. 5G-Kommunikation, autonomes Fahren oder High Performance Computing.

Dr. Michael Schiffer, Projektleiter am Fraunhofer IZM, sagt: "Im März hatten wir ein sehr anregendes Treffen mit dem Präsidenten von Rapidus, Dr. Atsuyoshi Koike. Er betonte, wie wichtig es sei, nicht nur die beste 2nm Chiptechnologie zu entwickeln, sondern auch High-End Packaginglösungen, um Technologieführer zu werden. Ich freue mich sehr auf eine fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten!"

High Performance Computing Module

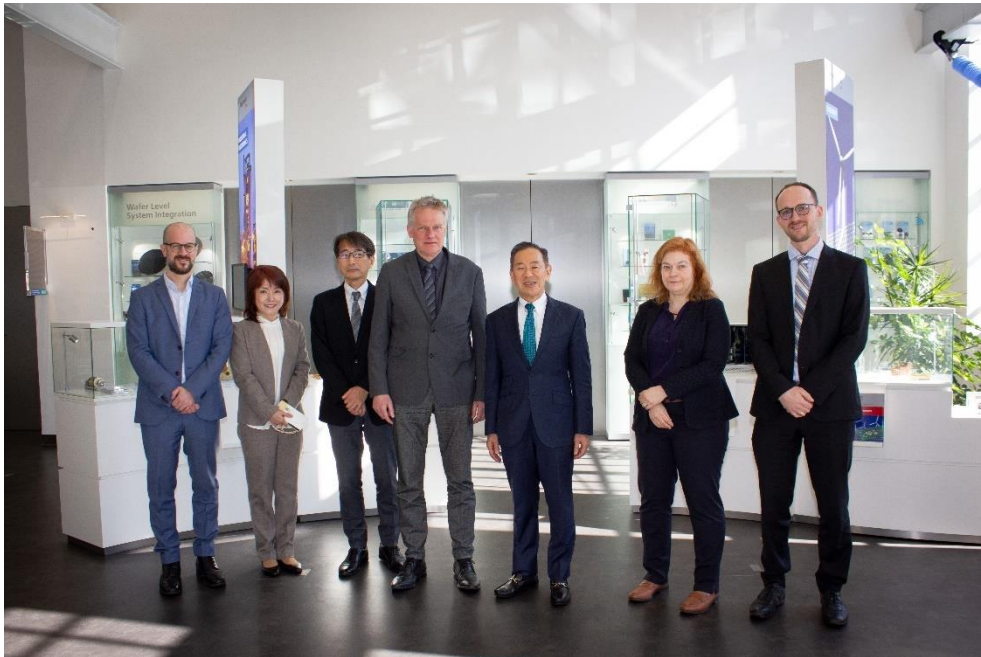


High Performance Computing Modul. © Rapidus: Übernommen und übersetzt aus: https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/pdf/240402_theme_01.pdf | Grafik in Druckqualität: www.izm.fraunhofer.de/en/news_events/pics.html

Redaktion

Georg Weigelt | Telefon +49 30 46403-279 | georg.weigelt@izm.fraunhofer.de |

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | www.izm.fraunhofer.de |



Dr. A Koike (Präsident der Rapidus Corp., 3. Person von rechts) und Prof. Dr. M. Schneider-Ramelow (Institutsleiter des Fraunhofer IZM, 4. Person von rechts) © Fraunhofer IZM | Bild in Druckqualität: www.izm.fraunhofer.de/en/news_events/pics.html

Die **Fraunhofer-Gesellschaft** mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 3 Milliarden Euro. Davon fallen 2,6 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung.

Hoch integrierte Mikroelektronik ist allgegenwärtig und bleibt doch fürs bloße Auge meist unsichtbar. Seit über 30 Jahren unterstützen wir an den Standorten Berlin, Dresden und Cottbus Startups sowie mittelständische und internationale Großunternehmen mit Technologietransfer für intelligente Elektroniksysteme der Zukunft. **Das Fraunhofer IZM** deckt mit vier zentralen Technologie-Clustern eine große Bandbreite aus den Bereichen Quantentechnologie, Medizin-, Kommunikations- und Hochfrequenztechnik ab. Mit unserer weltweit führenden Expertise bieten wir unseren Kund*innen kostengünstige Entwicklung und Zuverlässigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien sowie maßgeschneiderte Systemintegration auf Wafer-, Chip- und Boardebene.

Fachlicher Ansprechpartner

Dr. Michael Schiffer | Telefon +49 30 46403-234 | michael.schiffer@izm.fraunhofer.de |

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | www.izm.fraunhofer.de |